

SMT 256 浸漬膠合劑產品資料表

增強焊點可靠性

免除底部填充膠

高良率

簡介

SMT 256 系列浸漬型胶水主要针对 CSP、BGA、倒装芯片和层叠封装产品，用于增强焊点可靠性和消除焊点裂痕，特别适于无铅应用时代。SMT 256 是一种聚合胶水，当元器件浸渍到 SMT 256 的薄膜中时，它能包裹元器件锡球。在回流过程中这种聚合胶水可以去除金属氧化物，在形成焊点的同时形成三维机构的聚合网络以包裹每一个焊点。它可以增强焊点的可靠性并解决底部填充胶的部分缺点(Tg 点以上热膨胀系数很大，工艺控制困难)。跌落测试的结果显示该胶水的使用性能比锡膏高出两个数量级。

物理特性

产品名称	SMT 256 浸渍型胶水
外观	无色或淡黄色液体
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.05
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	10-50k cp
定量卤化物含量	0%
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm

表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)
--------------------	-----------

應用

SMT 256 系列產品可採用浸塗、點膠、印刷(模板或網版印刷)或接腳轉印等製程進行塗覆。SMT 256 系列產品用量過少會導致焊點空洞或焊點開路;用量過多則會導致焊橋或焊料溢出。為了獲得高效益和最佳可靠性,必須優化 SMT 256 系列產品的塗覆製程參數。

回流焊接和固化

SMT 256 系列產品與目前的SMT組裝流程以及所有類型的焊盤表面處理(例如Ni/Au、浸銀、OSP)完全相容。它可在空氣或氮氣環境下,用於對流、傳導、紅外線或氣相焊接系統。從室溫升至峰值溫度的時間應為4至5分鐘,峰值溫度範圍為230°C至260°C。

儲存和保存期限

如果將材料保存在密封的原始容器中,並在-20°C 或更低的溫度下儲存,保存期限為 6 個月。超過此期限儲存可能會導致黏度升高。請防止受潮、蒸發和外來物污染。蒸發和污染會嚴重影響這些產品的加工性能。

安全信息

SMT 256 是一種環保無毒材料,我們建議採用普通生產防護方法處理該產品。詳情請查閱我們的 產品安全數據表。

包裝規格

SMT 256 系列膠合劑提供 5 cc, 10 cc 和 30 cc 三種包裝規格,也可根據客戶要求提供其他包裝方式。請聯繫英凱公司了解更多訂購信息。